



2026年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 代表取締役社長執行役員 伊藤 暁
(コード番号6125 東証 スタンダード市場)
問合せ先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

第三者割当増資における調達資金の資金用途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月22日付「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」及び2026年6月12日付「第三者割当増資における調達資金の資金用途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において開示いたしました第三者割当増資（以下「第三者割当」という。）に係る調達資金の資金用途及び支出予定時期について、一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、2026年6月12日付「第三者割当増資における調達資金の資金用途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金のうち、下記⑤に記載の「①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金」への充当を検討しているものの、具体的な金額及び支出予定時期は未定である旨を開示しておりました。

その後、当該施設の活用方針及び必要な機能強化の内容について社内検討を進めた結果、技術開発棟としてのラボ機能の向上及び人財戦略の拠点としての活用を目的とした改修工事等の具体的な内容を決定し、これに伴い、下記⑤に係る資金用途の金額及び支出予定時期を確定いたしました。

一方、下記⑥に係る資金につきましては、引き続き今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用について検討を継続しており、現時点において具体的な資金用途及び支出予定時期は未定であります。今後、具体的な内容が決定した場合には、速やかに開示いたします。

なお、下記⑤に係る資金は、前回開示において①及び④において減額した資金の一部を充当するものであります。

2. 変更の内容

当社は、2026年6月12日付「第三者割当増資における調達資金の資金用途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金の資金用途及び支出予定時期の一部変更を開示しており、その時点において、下記⑤および⑥に係る金額及び支出予定時期については未定としておりました。

今般、下記⑤に係る資金用途の具体的な金額及び支出予定時期を決定したことに伴い、前回開示時点の内容から下記のとおり変更いたします。

(なお、変更箇所は下線で示しております。)

(前回開示時点)

具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年8月～2027年3月
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月 (充当済)
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月 (充当済)
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	—	—
⑤ ①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金(予定)	未定	未定
⑥ 今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用(詳細未定)	未定	未定

(今回変更後)

具体的な用途	金額(百万円)	支出予定時期
① 半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年8月～2027年3月
② 次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年8月～2026年3月 (充当済)
③ 半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年6月～2026年2月 (充当済)
④ 大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	—	—
⑤ ①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金	800	2026年7月～2028年3月
⑥ 今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用(詳細未定)	3,969	未定

3. 業績への影響

資金用途の金額および支出予定時期の変更による当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、開示の必要性が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上